

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	西部证券、中金公司、长信基金、玖鹏资产、国泰君安资管、浦银安盛基金、硕腾投资、中银基金、华安基金、东方证券、金鼎资本
时间	2024年1月16日
地点	公司会议室及线上
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>问题一：电镀液产品国内市场规模？</p> <p>回答：1、传统封装用电镀液及配套试剂</p> <p>参考中国电子材料行业协会的数据测算，2021年国内传统封装电镀液及配套试剂（主要为引脚线镀锡产品）的市场需求大约为1万吨，预计2025年将增长至1.3万吨，复合增长率为6.78%。根据公司估算的产品市场价格测算，2021年国内传统封装电镀液及配套试剂的市场规模约3亿元，预计2025年增长至约4亿元。</p> <p>2、先进封装用电镀液及配套试剂</p>

参考中国电子材料行业协会数据测算，2021 年国内先进封装用电镀液及配套试剂（主要为镀铜产品）市场需求大约为 0.5 万吨，预计 2025 年将增长至 1 万吨，复合增长率为 18.92%。参考公司产品预期售价测算，国内先进封装用电镀液及配套试剂的市场规模将由 2021 年的 2.5 亿元增长至 2025 年的 5 亿元。

3、电子元件电镀液及配套试剂

（1）被动元件（MLCC、片式电阻）

根据中国电子元件行业协会的数据，2021 年国内 MLCC 需求量达到 38,480 亿只，占全球 MLCC 需求量的 76.70%。参照国内 MLCC 需求量占全球 MLCC 需求量的比例测算，2021 年度国内 MLCC 及片式电阻镀锡电镀产品的市场规模约为 2-3 亿元人民币，2025 年将 3-4 亿元，复合增长率为 7%-11%。

（2）PCB（HDI）镀铜

根据中国电子电路行业协会发布的市场分析，中国大陆 2021 年 PCB 电镀专用化学品市场规模约为 26-30 亿元，整体国产化率为 25%；其中，公司已量产的不溶性阳极电镀产品所属的市场的国内产值约为 8-12 亿元，该市场主要由日本 JCU、美国乐思、美国陶氏、德国安美特等国际企业占据大部分市场份额。

问题二：公司先进封装电镀液产品有哪些？销量如何？

回答：先进封装电镀液产品主要包括铜电镀基液及电镀添加剂，国内企业目前主要提供电镀铜基液产品，公司先进封装的电镀铜基液（高纯硫酸铜）进入量产阶段，相关产品目前尚处于起步阶段，2022 年度销售金额约 144 万元，较 2021 年度增长超过 84.96%，市场占有率较小但增速较快。除已经实现电镀铜基液（高纯硫酸铜）量产外，公司先进封装镀铜添加剂目前处于客户认证阶段。

关于本次活动是否

无

涉及应当披露重大信息的说明	
附件清单（如有）	无
日期	2024年1月17日